

レーザ微細加工装置 SL527A/B シリーズ

試作・多品種少量ロット生産向け
汎用微細レーザ加工装置

特長

加工用途に適したレーザ光源が選択可能

カスタム対応可能な光学系

優れた操作性のGUI制御ソフトウェア

個別対応可能な周辺機器

高精度・高品質加工設計

用途

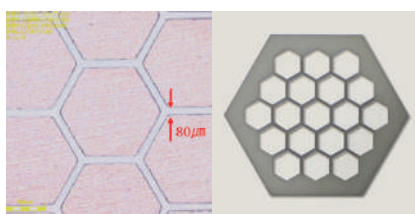
- ポリイミド樹脂加工、アブレーション
- Cu、ALカット、アブレーション
- サファイヤガラスカット、アブレーション
- セラミックスカット、アブレーション
- 薄膜パターニング



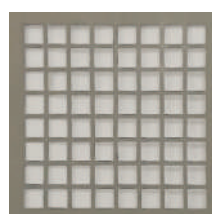
レーザ微細加工機 SL527A/Bシリーズ

加工事例

■ 532nm



アルミナセラミックス
0.2mm厚

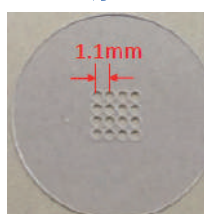
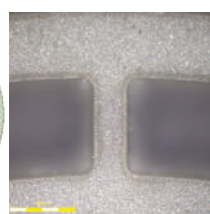


アルミ
0.1mm厚

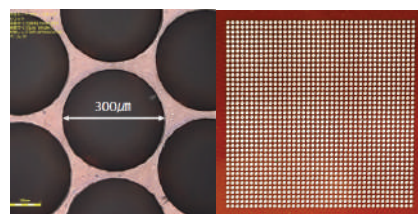
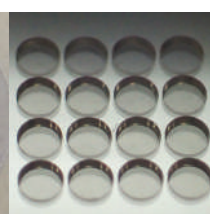
■ 355nm



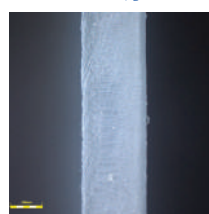
圧電素子 (PZT)
0.1mm厚



サファイヤガラス
0.3mm厚



ポリイミド樹脂
0.125mm厚

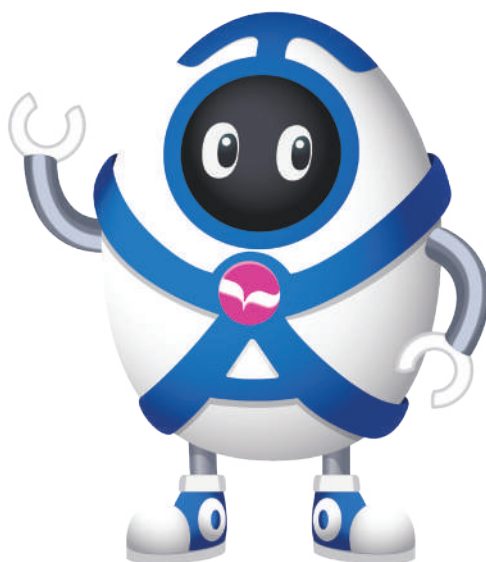


PTEF樹脂
0.2mm厚

仕様

項目	SL527AS	SL527AT	SL527BS	SL527BT
本体共通仕様				
加工方式	高速スキャナと高精度 XY 軸ステージの組合わせ制御			
XY 軸ステージ	有効ストローク XY 軸 520mm リニアスケール付			
Z 軸ステージ	選定レンズの高さ調整、及びビーム焦点位置の微調整用			
θ軸ステージ	加工ワークの角度(θ)調整用			
加工ワーク載物台 (XYθ軸上に搭載)	450mm 以内の平面プレート：ワーク保持 真空吸着または手動クランプ(配置はご相談)			
モニタカメラ	①加工点同軸カメラ ②アライメントカメラ ③加工部観察カメラ			
制御部	パソコン、多軸モーションコントローラ			
外形・重量	本体：1500(W)×1500(L)×1700(H)・約 1.5ton			
レーザ発振器、光学系				
レーザ仕様	ピコ秒、SHG	ピコ秒、THG	ナノ秒、SHG	ナノ秒、THG
波長	532nm	355nm	532nm	355nm
パルス幅	<15ps		<25ns	
繰り返し	200kHz～1000kHz		0～500kHz	
平均出力	>25W@200kHz	>16W@200kHz	～20W 選択@50kHz	～15W 選択@50kHz
ビーム集光サイズ	約φ10～80μm	約φ7～50μm	約φ10～80μm	約φ7～50μm
空間モード	TEM00 シングルモード			

お気軽に試作・サンプル加工お問い合わせください!



トワッピー ©TOWA

TOWAレーザーフロント株式会社

<https://www.laserfront.jp>

E-mail : tlf_moreinfo@laserfront.com

本社 〒252-5298 神奈川県相模原市中央区下九沢1120 (NEC相模原事業場内)

TEL: 042-700-3431

中部オフィス 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄2丁目2番17号 名古屋情報センタービル3F

TEL: 052-222-2475

関西オフィス 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島5丁目3番10号 イトーピア新大阪ビル2F

TEL: 06-6734-6255